

产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

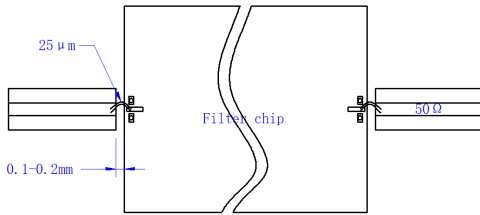
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10000	~	14000	MHz
中心损耗	/	/			2.7	dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	8.8&15.45	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.5&15.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.05	GHz≥	50			dB
带外抑制	15.8-22.9	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



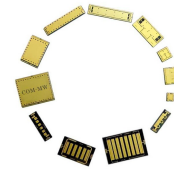
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用50μm×10μm的金带或2根25μm的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

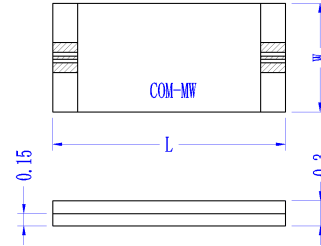
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图



外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图

